



MOSFET automotive compatti e robusti con fianchi bagnabili

Il nuovo package DFN2020B (WF) migliora l'affidabilità, la miniaturizzazione e l'ispezione ottica automatica (AOI) per le applicazioni automotive di prossima generazione

Düsseldorf, Germania, 24 marzo 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») annuncia il lancio di cinque nuovi prodotti MOSFET per automotive, progettati per offrire una combinazione di vantaggi quali la riduzione dell'ingombro e la facilità di montaggio. Questi MOSFET a canale N ([XSM6K361NW](#), [XSM6K519NW](#), [XSM6K376NW](#), e [XSM6K336NW](#)) e a canale P ([XSM6J372NW](#)) sono alloggiati nel package DFN2020B (WF), che presenta una struttura a fianco bagnabile.

Questo package rappresenta un progresso significativo nel campo dell'elettronica automotive e offre numerosi vantaggi. La struttura a fianco bagnabile migliora la bagnabilità della saldatura rispetto al package UDFN6B esistente di Toshiba. Fondamentalmente, questa soluzione migliora anche la visibilità del filetto di saldatura, e ciò consente di verificare la qualità del giunto di saldatura utilizzando apparecchi di ispezione ottica automatizzata (AOI). Inoltre, nei test di resistenza al taglio dei giunti di saldatura, il nuovo package mostra una resistenza superiore di circa il 23 % rispetto al package SOT-23F esistente di Toshiba, contribuendo ad assicurare una maggiore affidabilità.

Con dimensioni tipiche di 2,0 mm x 2,0 mm x 0,6 mm, il package DFN2020B (WF) riduce l'area di montaggio di circa il 43 % e l'altezza di circa il 25 % rispetto al package SOT-23F (2,4 mm x 2,9 mm x 0,8 mm tip.). Tale riduzione delle dimensioni è fondamentale per la miniaturizzazione dei moderni apparecchi automotive.

Nonostante le dimensioni compatte, il nuovo package presenta un'elevata capacità di dissipazione di potenza. Ad esempio, l'[XSM6K361NW](#) vanta una potenza massima di dissipazione di 1,84 W, che è circa 1,5 volte superiore rispetto ai 1,2 W che caratterizzano

il prodotto SSM3K361R esistente di Toshiba nel package SOT-23F. Questa elevata capacità di dissipazione di potenza supporta lo sviluppo di apparecchi automotive compatti che richiedono MOSFET ad alta potenza, come i convertitori DC-DC per le centraline elettroniche (ECU) e gli interruttori di carico per i fari a LED.

Questi nuovi prodotti sono conformi alla norma AEC-Q101, la specifica di test di affidabilità standard nel settore automotive. Inoltre, è disponibile il Processo di Approvazione delle Parti di Produzione (PPAP) dello IATF16949, lo standard internazionale per i sistemi di gestione della qualità specifici per l'industria automobilistica.

Toshiba si impegna ad espandere la propria gamma di prodotti MOSFET con il package DFN2020B (WF), nonché a introdurre in futuro prodotti MOSFET 2 in 1 con il package DFN2020(WF) per applicazioni automotive.

Per informazioni dettagliate sui nuovi MOSFET automotive nel package DFN2020B (WF), visitate il sito Web di Toshiba:

[XSM6K361NW](#)

[XSM6K519NW](#)

[XSM6K376NW](#)

[XSM6K336NW](#)

[XSM6J372NW](#)

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, di controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Oltre agli hard disk, l'ampio portafoglio dell'azienda comprende semiconduttori di potenza e altri dispositivi discreti che vanno dai diodi ai circuiti integrati logici, ai semiconduttori ottici, ai microcontrollori e ai prodotti standard specifici per un'applicazione (ASSP), tra gli altri. Inoltre, TEE offre anche celle e moduli per batterie SCiB™ con ossido di litio e titanio (LTO) per applicazioni pesanti.

TEE ha la propria sede centrale a Düsseldorf, in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito che forniscono servizi di marketing, vendita e logistica.

Visitate i siti Web di Toshiba all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com e www.scib.jp/en per maggiori informazioni sull'azienda e sui suoi prodotti.

Indirizzo di riferimento per le pubblicazioni:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)7464 493526

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0) 172 617 8431

Web: www.pretzl.com

E-mail: birgit.schoeniger@pretzl.com

Marzo 2026

Rif. 7638I